

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2025-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	山西证券杜鹏程, 国金证券周焕博, 亚洲红马投资高鼎、陈一鸣, 国宝人寿邹斌, 高毅资产王骊鹏, 泰康资管刘勍等 10 名投资者。	
时间	2025 年 12 月 26 日 15:30-16:00	
地点	线上会议	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘力; 证券事务代表陈晓芬、程筱玥。	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍鼎龙蔚柏基本情况</p> <p>鼎龙蔚柏在半导体生产领域主要为客户提供半导体晶圆载具和洁净包装物等产品, 致力于为半导体制程提供全方位、高精度的承载、运输产品。目前在研产品包括 FOUP、FOSB、HWS、光罩载具、超洁净桶等多款产品。</p> <p>二、提问与交流</p> <p>1、请问公司半导体载具自 2024 年获得的首个量产订单, 目前的交付进展如何? 是否已形成收入?</p> <p>回复: 鼎龙蔚柏自 2024 年通过客户验证并获小批量订单后, 期间持续根据客户的订单情况进行产品交付, 2025 年相关产品已形成上千万元销售收入。</p> <p>2、公司半导体板块的晶圆载具产品开始大批量供货了吗? 是否有进一步的进展情况?</p> <p>回复: 2025 年第四季度, 公司已陆续向客户交付多批产品订单。近日, 鼎龙蔚柏在某国内晶圆厂商 2026 年度相关半导体晶圆载具及耗材需求意向中获得 60%-70% 的份额, 公司首次获得大批量意向订单。此外, 半导体晶圆载具国产供应商份额占有比例首次超过进口供应商。</p> <p>3、公司获得这个意向性订单意味着什么?</p> <p>回复: 本次意向性订单的落地, 标志着鼎龙蔚柏已具备稳定量</p>	

	<p>产及持续供货能力，更意味着明年将进入规模化批量供应阶段，产能将进一步释放。此次订单的顺利获取，将有效推动公司半导体耗材业务的市场拓展，进一步巩固公司在 12 寸晶圆载具领域的竞争优势，显著提升公司作为国产半导体晶圆载具核心供应商的行业知名度与品牌影响力。</p> <p>4、公司半导体板块产品市场空间及进展如何？</p> <p>回复：鼎龙蔚柏目前在研产品包括 FOUP、FOSB、HWS、光罩载具、超洁净桶等多款产品，目前多个产品进入国内多家主流晶圆厂、硅片厂、封测厂、掩膜版厂、湿电子化学品厂的“小批量及验证”阶段，国内相关产品年市场规模合计约 30 亿元。2026 年，公司预计会在 FOSB、光罩载具、超洁净桶等产品取得进一步突破。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 12 月 26 日